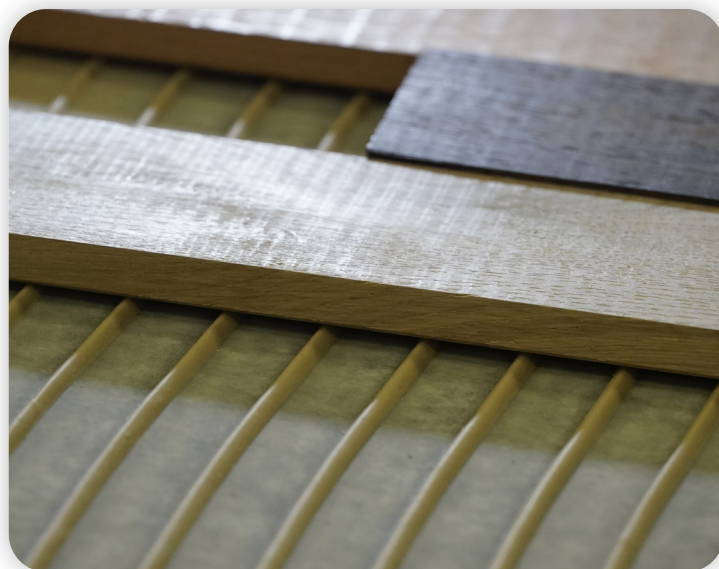




SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



МАТЕРИАЛЫ



ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СУДОСТРОЕНИЕ



СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАВЫ



ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

SMP BOND

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ MS-ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Однокомпонентный, MS-полимерный, отверждаемый при реакции с влажностью окружающей среды клей, без запаха, соответствующий стандарту ISO 17178:2013, для приклеивания всех типов традиционного и предварительно обработанного паркета на впитывающие и невпитывающие основания. Не содержит растворителей, воды, аминов, эпоксидных смол и изоцианатов, быстро схватывается и не дает усадки. Продукт характеризуется высокой когезией, постоянной эластичностью, отличной влажностойкостью и адгезией к основаниям. SMP BOND является продуктом с низким содержанием летучих органических соединений и классифицируется EC1 Plus немецким органом по сертификации GEV, а также соответствует требованиям Руководства по Энергоэффективному и Экологическому Проектированию (сертификация LEED).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью шпателя Lechner n.6



Подходит для использования в помещении



Подходит для полов с подогревом



Рабочее время
40 минут
Время до легкой эксплуатации
12 часов
Время полного высыхания
48 часов



Внешний вид
Пастообразный



Цвет
Светло-коричневый



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Химическая основа
МС-полимер



Расход
800-1200 г/м²



Температура применения
+15 - +25 °C



Очистка
Инструменты с помощью Solvent CH 500
Остатки и загрязнения с помощью Cleancoll или Eco Cleancoll (пока продукт не высох)

СЕРТИФИКАТЫ



Продукт с очень низким содержанием летучих органических соединений, сертифицированный немецким GEV



Продукт с очень низким содержанием летучих органических соединений (постановление Франции № 2011-321 от 23.03.2011)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, таких как масло, воск и т.п. Если имеются трещины или разломы, их необходимо заделать с помощью SIGEPOX. Максимально допустимое содержание влаги:

- Бетонные основания макс. 2,0%; с подогревом 1,7%.
- Гипсовые или ангидритные основания макс. 0,5%; с подогревом 0,2%.

Убедитесь, что нет признаков повышения влажности. Поверхности с повышенным пылеобразованием и недостаточно плотные или сильно абсорбирующие основания следует обработать грунтовкой PRIMER AC PLUS или PRIMER 99. Основания с недостаточно ровной или наклонной поверхностью можно выравнивать с помощью выравнивающих продуктов на цементной основе, таких как LIVELLANTE 140M, ULTRADUR, RASODUR, RASODUR MAXI, LEVELFAST или LEVELFAST S после подготовки поверхности с помощью PRIMER 99. Слабовпитывающие и невпитывающие поверхности необходимо обработать ECOGRIP или ECOGRIP PLUS для обеспечения требуемой адгезии после чего можно будет использовать выравнивающие составы толщиной не менее 2-3 мм. Ангидритовые основания должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Основания с повышенной влажностью (макс. 5%) должны быть гидроизолированы подходящими грунтовками серии PU, EPOPRIMER или TRIX в зависимости от впитывающей способности поверхности, отшлифованы и затем выровнены с минимальной толщиной не менее 2-3 мм. В этом случае на последний слой гидроизоляции, пока она еще свежая, необходимо насыпать большое количество сухого кварцевого песка подходящего размера (0,5 - 1 мм), впоследствии удалив излишки песка, которые не закрепились после высыхания грунтовки, чтобы гарантировать требуемую адгезию. Основания с подогревом можно только укреплять, но не гидроизолировать (при необходимости обратитесь в технический офис). Для непосредственного приклеивания к старым деревянным полам необходимо проверить адгезию старой древесины к стяжке, отшлифовать древесину, обеспылить, после чего приступить к укладке. Перед укладкой убедитесь, что в комнатах есть окна. Убедитесь, что влажность паркета составляет от 7 до 11%. Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя соответствующего размера. Укладка паркета осуществляется с оступом от стен (около 1 см), и избегая бокового торцевого склеивания. Придавите элементы уложенного паркета для

обеспечения корректного контакта с клеем, как минимум в течение рабочего времени клея (40 минут), а лучше - до его полного высыхания. Сразу же после использования клея, в случае его не полной выработки, необходимо закрыть емкость, уложив на поверхность неиспользованного клея специальный защитный лист - для того, чтобы влага, присутствующая в воздухе внутри ведра, не вступила в реакцию с клеем и не вызвала его затвердевания. Продукт не подлежит разбавлению каким-либо образом.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заранее убедитесь, что основание подготовлено для укладки соответствующим образом. Указанные время нанесения и высыхания относятся к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Продукт должен пройти акклиматизацию до комнатной температуры перед использованием. Прежде чем приступить к строганию, шлифованию и последующей отделке деревянного пола, необходимо подождать, пока паркет стабилизируется. SMP BOND можно удалить сухой тряпкой, когда он еще свежий; в качестве альтернативы его можно удалить с помощью CLEANCOLL или ECO CLEANCOLL, предварительно проведя тест на еще не уложенной деревянной детали. После застывания клея его можно удалить только механическим способом.

ИНСТРУКЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ: Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет и заменяет содержание предыдущего издания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.